

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20240112

| | |
|---------------------------|--|
| 投资者关系 活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称 及人员姓名 | 国君资管：冯自力、肖凯；中信证券：孙臣兴；中庚基金：孙伟；开源证券：刘天文；西部证券：贾国瑞；中银资管：叶志成；财通证券：白宇；海富通基金：赵莹洲；长信基金：肖文劲；泓澄投资：陈骞；平安证券：徐碧云；广发证券：牛璐等 13 名投资者及证券人员 |
| 时间 | 2024 年 01 月 11 日 13:30~15:00 |
| 地点 | 公司 9 楼会议室 |
| 上市公司接待 人员姓名 | 投资者关系经理朱梦茜女士 |
| 投资者 关系活动 主要内容 介绍 | <p>管理层介绍公司基本情况，并与投资者就公司半导体材料业务、打印复印通用耗材业务的经营及其他投资者关心的问题进行深入交流，主要交流内容如下：</p> <p>问 1：公司半导体材料业务 2023 年第四季度整体市场推进情况如何？ 答：2023 年，公司重点开展半导体材料业务的市场开拓工作，扩展各半导体材料产品的下游客群，提升在已有客户中的占有率水平。从前三季度来看，公司 CMP 抛光垫、CMP 抛光液及清洗液、半导体显示材料业务的销售收入均实现了季度环比提升。公司在第四季度保持了以市场为导向的工作态势，努力推动公司半导体材料业务的持续积极成长。</p> <p>问 2：公司 CMP 抛光垫业务未来有何发展规划？ 答：公司是国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的 CMP 抛光垫的国产供应商，现已深度渗透国内主流晶圆厂供应链，国产替代领先优势明显。目前，公司 CMP 抛光垫产品在客户端规模销售稳步推进，目标市占率进一步提升。</p> <p>问 3：公司半导体显示材料的放量预期如何？ 答：2023 年前三季度，公司半导体显示材料业务实现销售收入超 1 亿元，收入逐季度环比增长，且在第四季度也保持了良好的市场态势。随着</p> |

| | |
|------|---|
| | <p>OLED 面板在终端应用的渗透占比持续提升，国内终端 AMOLED 面板市场规模的持续增长，下游国内主流面板厂客户 OLED 产能有望进入快速释放期。公司也会持续进行市场开拓工作，努力提升公司 YPI、PSPI 产品在国内市场的市占率水平，同时有计划地推进其他显示材料新品的验证、导入工作，目标在 2024 年保持公司半导体显示材料业务的销量提升态势。</p> <p>问 4：公司 CMP 抛光液业务进展情况如何？</p> <p>答：2023 年是公司 CMP 抛光液业务正式推进的第三年，在过去的三年内，公司实现了 CMP 抛光液上游核心原材料—研磨粒子的自主制备，推进了全制程 CMP 抛光液产品的开发和市场推广，完成了武汉本部年产 5000 吨 CMP 抛光液产线和仙桃年产 1 万吨 CMP 抛光液及配套研磨粒子产线的布局。后续公司将重点推进各制程 CMP 抛光液产品在下游主流晶圆厂客户端的导入工作，努力扩大 CMP 抛光液产品的销售规模，加快仙桃园区万吨级 CMP 抛光液及研磨粒子产线的产能爬坡进度，争取早日实现 CMP 抛光液产品的规模毛利水平并发挥研磨粒子自制的成本优势，推动该业务逐步增长为公司新的利润增长极。</p> <p>问 5：公司如何看待近几年和未来的研发投入水平？</p> <p>答：公司近几年保持较高研发投入水平，主要系抓住半导体材料行业布局的黄金窗口期，实现细分领域的国产领先优势。现阶段公司 CMP 抛光垫业务、半导体显示材料 YPI、PSPI，以及 CMP 抛光液和清洗液业务都陆续走向规模销售阶段，相关产品的研发强度会较开发阶段有所下降。同时公司技术开发平台和检测平台等平台化的布局逐步完善，技术人才配置逐渐完备。公司新项目开发转化加速，开发成本降低，平台化协同效应体现。后续公司的研发投入水平会根据公司战略规划保持在合理区间。</p> <p>问 6：公司半导体封装 PI 业务的进展情况如何？</p> <p>答：公司在半导体先进封装材料领域布局了半导体封装 PI、应用于先进封装工艺中的 CMP 抛光材料、临时键合胶三类产品，其中半导体封装 PI 是公司重点推进的部分。半导体封装 PI 业务与公司已有半导体面板显示材料 YPI、PSPI（光敏聚酰亚胺）业务高度相关，属于公司现有技术在不同应用领域的延伸拓展。目前公司半导体封装 PI 产品领域覆盖非光敏 PI、正性 PSPI 光刻胶和负性 PSPI 光刻胶，应用领域全面覆盖前道晶圆制造 IGBT 功率模块的封装和后道的半导体先进封装，已有数款产品处于客户端验证阶段。</p> |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2024 年 01 月 11 日 |